

# Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica EIE

Escuela de **Ingeniería Eléctrica** 

#### IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores

Jorge Adán Mora Soto, B95222 Jafet David Gutiérrez Guevara, B73558 jorgeadan.mora@ucr.ac.cr jafet.gutierrez@ucr.ac.cr

2 de noviembre de 2022

## Laboratorio 4 STM32: GPIO, ADC, comunicaciones, Iot

#### Resumen

En está práctica de laboratorio se desarrolló un sistema que emula un sismógrafo digital para registrar y estudiar las oscilaciones en el edificio de la escuela de ingeniería eléctrica. El sismógrafo actual tiene alimentación por baterías (cargadas por paneles solares) y poco ancho de banda para el envío de datos. Por lo tanto el simógrafo a desarollar utiliza una placa STM32F429 Discovery kit y la biblioteca libopencm3, lee los ejes x, y, z del giroscopio incluido en el STM32F429 Discovery kit y despliega tales valores en una pantalla LCD; Además incluye un switch que habilita y deshabilita comunicaciones por USART-USB; a su vez, cuando la batería está baja cerca de su límite inferior, un led parpadea alertando el estado de la batería. Por último este sismógrafo se conecta a través de MQTT a una plataforma de IoT thingsboard en internet para desplegar sus lecturas de manera amigable para el usuario. El proyecto planeta un prototipo; únicamente se utilizan los componentes integrados en el STM32F429 Discovery kit físico. No se realiza simulaciones. El proyecto se concluyó con éxito.

Link del Proyecto: Ohttps://github.com/Jams1001/IE0624/tree/main/L4

ID del último commit de interés:e96a6fcf3fcca333e339f4346ee823d04a5a9c9e

#### Instrucciones de simulación:

El directorio **spi-gyro** que se entrega bajo el path L4/src/spi-gyro/ **debe copiarse al directorio de ejemplos de la librería** libopencm3. Es indicación de este laboratorio trabajar con esta librería disponible en libopencm3 / libopencm3-examples. Una vez instalada esa librería y copiada la carpeta **spi-gyro** dentro del directorio de ejemplos de la misma, se debe realizar el «flasheo». Por ejemplo, **spi-gyro** se debe copiar al siguiente path:

/home/jams/local/src/libopencm3-examples/examples/stm32/f4/stm32f429i-discovery/ Una vez dentro del nuevo directorio:

/home/jams/local/src/libopencm3-examples/examples/stm32/f4/stm32f429i-discovery/spi-gyro/ Ejecutar la sintaxis en este orden:

make
make flash

Una vez «flasheado» el firmware, ya se puede ejecutar el gyro\_publisher.py adjunto en el entregable.



Figura 1: Incubadora automática.

#### 1. Nota Teórica

#### 1.1. Información general del MCU

STM32 es una familia de circuitos integrado de microcontroladores desarrollada por STMicroelectronics. Los chips STM32 están agrupados en series relacionadas que están basadas todas en el mismo núcleo de procesador ARM de 32-Bits.

A continuación un resumen de los procesadores y las series mencionadas:

STM32 series	ARM CPU Core
L5, U5	Cortex-M33F
F7, H7	Cortex M7F
F7, F4, G4, L4, L4+, WB	Cortex M4F
WL	Cortex-M4
F1, F2, L1	Cortex-M3
G0, L0	Cortex-M0+
F0	Cortex-M0

Tabla 1: STM32 series [1]

En este laboratorio se utilizará la serie F4; es la primera basada en el Cortex M4F. Además es el primer MCU de toda la familia STM32 en tener DSP e instrucciones de punto flotante.

- $\blacksquare$  Procesador Core: ARM 32 bits Cortex-M4 con FPU (RISC) [2].
- Operación: 180MHz [2].
- $\blacksquare$  Memoria: 2MB flash, 256KBSRAM [2].
- $\blacksquare$  Controlador LCD-TFT para la pantalla LCD [2].

- Posibilidad de operar a baja potencia (1.8 a 3.6 voltios) [2].
- Posee convertidores Analógico-Digital 3x12bit [2].
- Posee 2x12bit convertidores Digital-Analógico [2].
- Posee 17 Timers: 12 timers de 16 bits, 2 de 32bits de hasta 180MHz, cada timer con 4IC/O-C/PWM [2].
- Funciones para depuración: SWD y JTAG [2].
- 168 I/O para realizar interrupciones [2].
- Posee 21 interfaces de comunicaciones (entre estas I2C, USART, SPI, SAN, CAN) [2]...
- Posee conectividad avanzada USB 2.0 [2].
- Posee interfaz de cámara [2].
- Unidad para generar números aleatorios True NRG (Random Number Generator) [2].
- Posee una unidad para poder hacer CRC [2].
- Posee controladores DMA [2].

Posee las siguientes caracterísitcas eléctricas:

Symbol	Ratings	Min	Max	Unit	
V <sub>DD</sub> -V <sub>SS</sub>	External main supply voltage (including $V_{DDA}, V_{DD}$ and $VBAT)^{(1)}$	- 0.3	4.0		
	Input voltage on FT pins <sup>(2)</sup>	V <sub>SS</sub> - 0.3	V <sub>DD</sub> +4.0	] ,,	
V	Input voltage on TTa pins	V <sub>SS</sub> - 0.3	4.0	V	
$V_{IN}$	Input voltage on any other pin	V <sub>SS</sub> - 0.3	4.0		
	Input voltage on BOOT0 pin	V <sub>SS</sub>	9.0		
∆V <sub>DDx</sub>	Variations between different V <sub>DD</sub> power pins	-	50		
V <sub>SSX</sub> <del>V</del> <sub>SS</sub>	Variations between all the different ground pins including $V_{REF}$	-	50	mV	
V <sub>ESD(HBM)</sub>	Electrostatic discharge voltage (human body model)	see Sectio Absolute n ratings (ele sensitivity)			

Figura 2: Características de voltaje [3].

Symbol	Ratings	Max.	Unit
$\Sigma I_{VDD}$	Total current into sum of all V <sub>DD_x</sub> power lines (source) <sup>(1)</sup>	270	
Σ I <sub>VSS</sub>	Total current out of sum of all V <sub>SS_x</sub> ground lines (sink) <sup>(1)</sup>	- 270	
I <sub>VDD</sub>	Maximum current into each V <sub>DD_x</sub> power line (source) <sup>(1)</sup>	100	]
I <sub>VSS</sub>	Maximum current out of each V <sub>SS_x</sub> ground line (sink) <sup>(1)</sup>	- 100	
	Output current sunk by any I/O and control pin	25	
I <sub>IO</sub>	Output current sourced by any I/Os and control pin	- 25	] .
21	Total output current sunk by sum of all I/O and control pins (2)	120	mA
Σl <sub>IO</sub>	Total output current sourced by sum of all I/Os and control pins <sup>(2)</sup>	- 120	
	Injected current on FT pins <sup>(4)</sup>	5/: 0	
I <sub>INJ(PIN)</sub> <sup>(3)</sup>	Injected current on NRST and BOOT0 pins (4)	- 5/+0	
	Injected current on TTa pins <sup>(5)</sup>	±5	
$\Sigma I_{\text{INJ(PIN)}}^{(5)}$	Total injected current (sum of all I/O and control pins) <sup>(6)</sup>	±25	

Figura 3: Características de corriente [3].

En la figura 4 se muesta el diagrama de pines y en la figura 5 la arquitectura del  $STM32\ F4$ . En este caso el STM32F429 incluye Cortex M4F - LQFP144

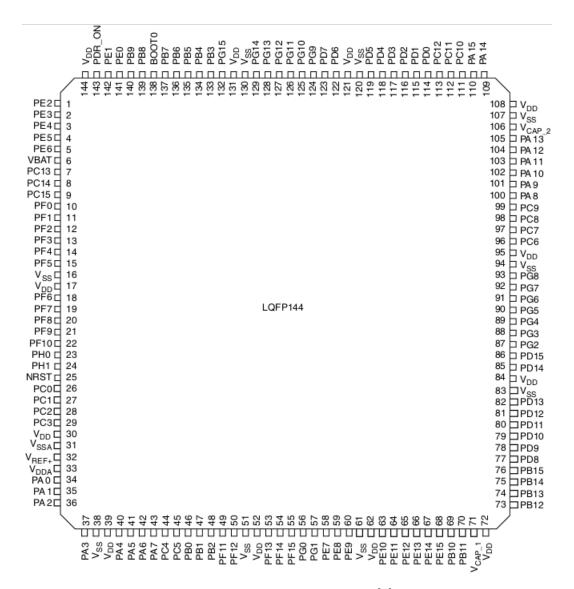


Figura 4: Diagrama de pines [3].

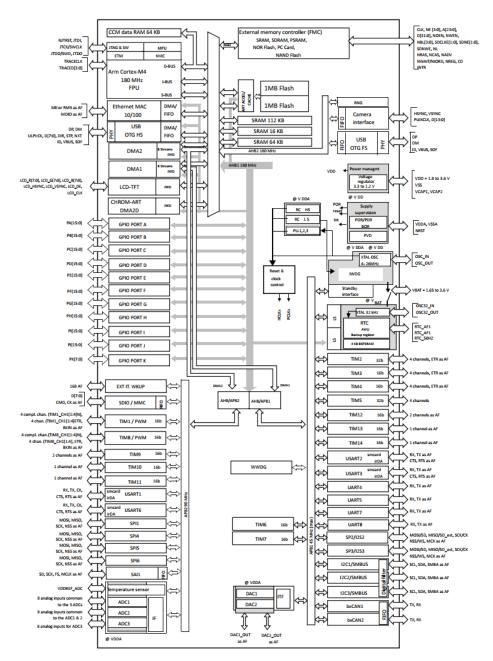


Figura 5: Diagrama de bloques [3].

#### 1.2. Sobre el STM32F429 Discovery kit

Es una placa de desarrollo que incluye el microcontrolador en cuestión entre otras herramientas complementarias. Cuenta con 6 leds, un giroscopio, dos botones; uno de *reset* y uno de *user*, un puerto USB micro-AB, una pantalla LCD, entre otras características muy útiles e interesantes [4].

#### 1.2.1. Giroscopio

El sensor de movimiento se trata del L3GD20 ST MEMS. Con 3 ejes de precisión. El L3GD20 es un sensor de velocidad angular de tres ejes ultra-compacto y de bajo consumo, posee elemento de detección y una interfaz IC con la capacidad de brindar una tasa angular a través de la interfaz serial

I2C/SPI. Posee escalas completas dinámicamente elegibles por el usuario de  $\pm 250 dps/500 dps/2000 dps$  [4].

#### 1.2.2. Pantalla LCD

Se trata de una pantalla LCD TFT (Thin-film-transistor liquid-crystal display) 2.4", 262K colores RGB, 240 x 320 puntos de resolución. Es impulsada directamente por el mcu usando el protocolo RGB. Usa el controlador ILI9341 LCD y opera con un voltaje de  $2.8 \pm 0.3V$ . El MCU mcu controla esta pantalla a través de la interfaz spi.

#### 1.3. Registros de interés

Tanto el microntrolador, como el giroscopio, como el módulo de la pantalla, tienen registros independientes. Del microncotrolador se ingresaron específicamente los periféricos. Entre los utilizados más importantes, los cuales se utilizaron para habilitar lecturas de otros registros, leer variables del giroscopio, ajustar variables físicas, entre otros:

- CTRL\_REG1
- CTRL\_REG4
- GYR\_OUT\_X\_L
- GYR\_OUT\_X\_H
- GYR\_OUT\_Y\_L
- GYR\_OUT\_Y\_H
- GYR\_OUT\_Z\_L
- GYR\_OUT\_Z\_H

Registros de interés del giroscopio:

Bus	Boundary address	Peripheral
	0x4008 0000- 0x4FFF FFFF	Reserved
	0x4004 0000 - 0x4007 FFFF	USB OTG HS
	0x4002 BC00- 0x4003 FFFF	Reserved
	0x4002 B000 - 0x4002 BBFF	DMA2D
	0x4002 9400 - 0x4002 AFFF	Reserved
	0x4002 9000 - 0x4002 93FF	
	0x4002 8C00 - 0x4002 8FFF	
	0x4002 8800 - 0x4002 8BFF	ETHERNET MAC
	0x4002 8400 - 0x4002 87FF	
	0x4002 8000 - 0x4002 83FF	
	0x4002 6800 - 0x4002 7FFF	Reserved
	0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2
	0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1
	0X4002 5000 - 0X4002 5FFF	Reserved
	0x4002 4000 - 0x4002 4FFF	BKPSRAM
AHB1	0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register
AHDI	0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC
	0X4002 3400 - 0X4002 37FF	Reserved
	0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC
	0x4002 2C00 - 0x4002 2FFF	Reserved
	0x4002 2800 - 0x4002 2BFF	GPIOK
	0x4002 2400 - 0x4002 27FF	GPIOJ
	0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI
	0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
	0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
	0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
	0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
	0X4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD
	0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
	0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
	0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA

Figura 6: Mapeo de registros el giroscopio utilizado [3].

Por parte del microcontrolador:

<b>D</b>	Baundari - dd	Perinharal
Bus	Boundary address	Peripheral
	0x4008 0000- 0x4FFF FFFF	Reserved
	0x4004 0000 - 0x4007 FFFF	USB OTG HS
	0x4002 BC00- 0x4003 FFFF	Reserved
	0x4002 B000 - 0x4002 BBFF	DMA2D
	0x4002 9400 - 0x4002 AFFF	Reserved
	0x4002 9000 - 0x4002 93FF	
	0x4002 8C00 - 0x4002 8FFF	
	0x4002 8800 - 0x4002 8BFF	ETHERNET MAC
	0x4002 8400 - 0x4002 87FF	
	0x4002 8000 - 0x4002 83FF	
	0x4002 6800 - 0x4002 7FFF	Reserved
	0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2
	0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1
	0X4002 5000 - 0X4002 5FFF	Reserved
	0x4002 4000 - 0x4002 4FFF	BKPSRAM
AUD4	0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register
AHB1	0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC
	0X4002 3400 - 0X4002 37FF	Reserved
	0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC
	0x4002 2C00 - 0x4002 2FFF	Reserved
	0x4002 2800 - 0x4002 2BFF	GPIOK
	0x4002 2400 - 0x4002 27FF	GPIOJ
	0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI
	0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
	0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
	0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
	0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
	0X4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD
	0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
	0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
	0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA

Figura 7: Mapeo de registros del giroscopio utilizado [4]

#### 1.4. Diseño

Nuevamente se aprovechan las capacidades del STM32F429 Discovery Kit y su gran integración para no tener que adapta electrónica al proyecto. La pantalla LCD, el led, y el switch, ya están integrados en la tarjeta de desarrollo, por esto no es neceserio diseñar estos componentes eléctricamente para un prototipo. Estos componentes ya están ajustados y funcionando en sus puntos de operación en cordinación el MCU, y realizar un diseño adicional sería para un modelo funcional y no un prototipo. Lo único que se debe adaptar es medir un valor de tensión analógico del que en teoría se debería alimentar la comunicación USB.

De modo que se debe diseñar con una batería de 9V. Como el voltaje de máximo del I/O utilizado es de 5V se diseña un divisor de tensión de modo que la tensión que se leerá en el pin cuando la batería tenga 9V será:

$$V_{out} = \frac{5 \cdot 100\Omega}{4 \cdot 100\Omega + 5 \cdot 100\Omega} \times 9V = 5V$$

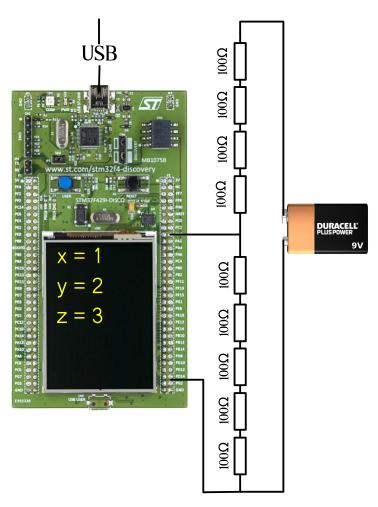


Figura 8: Esquemático final (Autoría propia).

#### 1.5. Componentes complementarios

El proyecto se trata de un prototipo por lo que en su mayoría se utilizaron los componentes integrados en el STM32F429 Discovery kit. Es decir, el switch, la pantalla, y el led del proyecto son solamente ejemplos de cómo podría funcionar el sismógrafo completamente. Adicional a esto se conecto una batería externa para simular el comportamiento que tendría en el circuito y por lo mismo fue necesario utilizar resistores.

Componente	Cantidad	Precio (USD)
Resistores $100\Omega$	10	1.6
Batería $9V$	1	2
STM32F429 Discovery kit	1	98.6
Total		102.2

Tabla 2: Lista de cantidad y precios de los componentes (Autoría propia).

#### 1.6. Conceptos

#### 1.6.1. IoT

Por sus siglas del inglés «*Internet of Things*», el Internet de las cosas, si de alguna forma se puede englobar en una definición, consiste en la interconexión de objetos por medio de una red, generalmente inalámbrica, donde exista una interacción entre los mismos sin la necesaria invervención del factor humano.

Podría tratarse de sensores, calzado, vestuario, o hasta un lápiz! Esta idea involucra comunicación entre dos máquinas o M2M (machine to machine) y por ende, machine learning. Al utilizar un microcontrolador que se conecte a internet y que cuando exista un estímulo de movimiento, como por ejemplo un sismo, envíe sus aceleraciones reales en forma de datos a internet para ser visualizadas por otro dispositivo en cualquier otra parte del mundo, se hace uso de IoT.

## 2. Desarrollo / Análisis de Resultados

#### 2.1. Análisis de SW

#### 2.1.1. Firmware

Para el desarrolló del firmware de este laboratorio, primeramente fue necesario configurar los pines del protocolo SPI que conectan microcontrolador STM32F429 con el giroscopio L3GD20 que trae integrado el Discovery kit. Para realizar esta configuración se tomaron como referencia las conexiones descritas en la figura 9.

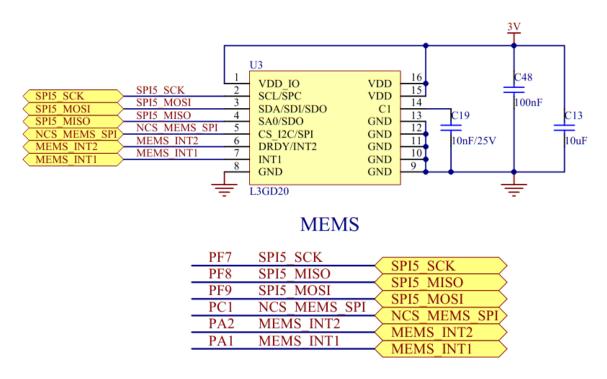


Figura 9: Conexión de pines entre el STM32F429 y el L3GD20

En la figura anterior, se puede observar que los pines de SPI del giroscopio corresponden al SPI5 del microcontrolador. Añadido a esto, se muestra que la entrada CS del giroscopio está conectado al pin PC1, la entrada SCL está unida al pin PF7, y las señales de MOSI y MISO están conectadas a los pines PF8 y PF9, respectivamente. Dicho esto, para configurar la comunicación por SPI entre el microcontrolador y el giroscopio, se tuvieron que habilitar los pines de los puertos PC y PF, además del SPI5. Para ello se utilizó la función rcc\_periph\_clock\_enable(). Por otro lado, el pin PC1 (CS) debe ser controlado por el microcontrolador, que en ese caso es el master, así que se habilito dicho pin como una salida utilizando la siguiente instrucción:

```
{gpio_mode_setup(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO1);
```

Por el contrario, los pines PF7 (SCK), PF8 (MISO) y PF9 (MOSI) son utilizados tanto por el giroscopio como el microcontrolador. Así que se habilitan en modo alternate function (AF) de la siguiente forma:

```
gpio_mode_setup(GPIOF, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO7 | GPIO8 | GPIO9);
```

Una vez hecho esto, solo se necesita escribir a los registros CTRL\_REG1 y CTRL\_REG4 para habilitar la lectura de los registros que capturan las variaciones de cada eje del giroscopio. Para configurar dichos registros se utlizó la función gpio\_clear() para poner en estado bajo el pin PC1 (CS) y se especificó la dirección del registro a escribir con la función spi\_send(). La respuesta se lee con spi\_read(), para después escribir los datos deseados de estos registros con otro spi\_send(), seguido de un spi\_read() para leer la respuesta. Este proceso termina al poner el pin PC1 (CS) en alto con gpio\_set().

Para leer los registros del giroscopio, primeramente se pone en bajo el pin PC1 (CS) a través de gpio\_clear(). Luego se manda la dirección del registro que se quiere leer con spi\_send() y se recibe la respuesta con spi\_read(). Después, se manda un 0 con spi\_send() y se vuelve a recibir la respuesta con spi\_read(). Dicha respuesta corresponde al valor de 8 bits del registro leído. Finalmente, el pin PC1 (CS) se vuelve a poner en estado alto con la función gpio\_set() A modo de ejemplo, a continuación se presenta la parte de código que realiza la lectura del registro bajo del giroscopio para el eje x (GYR\_OUT\_X\_L):

```
gpio_clear(GPIOC, GPIO1);
spi_send(SPI5, GYR_OUT_X_L | GYR_RNW);
spi_read(SPI5);
spi_send(SPI5, 0);
gyr_x=spi_read(SPI5);
gpio_set(GPIOC, GPIO1);
```

Posteriormente, se multiplica el valor crudo de los ejes del giroscopio por la sensitividad para un valor de 500 dps. Y por último, los valores leídos de cada 0eje se mandan por el puerto USB, mediante la USART1 del microcontrolador, a través de la función print\_decimal().

Para habilitar e inhabilitar el envío de los datos, se modificó la función print\_decimal() de tal manera que el botón de USER (PA0) dispara una permutación en el estado de la comunicación. Es decir, si la comunicación se encuentra habilitada y se presiona dicho botón por al menos un segundos, entonces el envío de datos se verá interrumpido. En el caso contrario, si el envío de datos estuviera inhabilitado y se presionase el botón, la comunicación se restablecería.

Finalmente, para medir la tensión proporcionada por la batería se creo un método llamado adc\_update(), el cual emplea la función read\_adc\_naiive() para hacer una lectura del pin PA1:

```
void adc_update(void){
          battery = read_adc_naiive(1)*9/4095;
}
```

Como se puede observar en la porción de código anterior, la lectura devuelta por read\_adc\_naiive se multiplica por 9 y se divide entre 4095 para obtener el valor de tensión asociado. La función adc\_update se llama en cada ciclo de ejecución para dar un valor actualizado de la batería. Además, si dicho valor es igual o menor a 7 se enciende el LED PG14 y se l

#### 2.1.2. gyro\_publisher.py

Este es el script encargado de recibir la comunicación serial por el MCU, decodificarla y postprocesarla para poder visualizarla en la terminal del ordenador. Adicionalmente este script toma ese array de datos que está en constante actualización cuando estén habilitadas las comunicaciones por USART/USB y lo envía a la plataforma de IoT en internet: ThingsBoard.

Consiste de 2 secciones principales. Una de conexión serial con el microcontrolador a través de comunicación USB y otro para establecer la conexión con ThingsBoard. Existen dos funciones para establecer si existe o no conexión, y otra para comunicar si se ha realizado la desconexión con éxito o no. La conexión con la plataforma de IoT se hace utilizando el protocolo de comunicación mqtt; protocolo standard de IoT. Los datos se deben enviar a la pltaforma en formato json. En las siguientes figuras se muestra el funcionamiento del software en la plafaforma ThingsBoard.



Figura 10: Dashboard ejemplo 1.

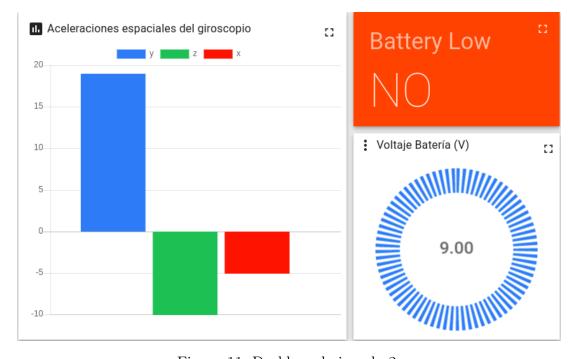


Figura 11: Dashboard ejemplo 2.

#### 2.2. Análisis de HW

A continuación se analiza el esquemático y sus componentes medidores para verificar su funcionamiento.

Nuevamente, el funcionamiento del led, el switch y de la pantalla LCD dependen del diseño de firmware, por lo que este funcionamiento no es tomando en cuenta en el análisis de hardware. Por otro lado la parte eléctrica funcionada debe funcionar de la siguiente manera. Cuando la batería esté a 7V, al pin entrarán 3.11V, lo cual implica una baja tensión cerca del límite mínimo de operación del MCU. En este momento el prototipo se encontrará en estado de batería baja, el led parpadeará y se enviará la notificación de batería baja a la plataforma de ThingsBoard.

Los datos del giroscopio, el led que se enciende para activar o desactivar la comunicación USART, el led de alarma para batería baja, el botón que funciona como switch, y la pantalla LCD funcionaron correctamente y no se muestran deficiencias aparentes el laboratorio. A continuación se presenta un link para accesar y ver un video de su correcto funcionamiento:

https://drive.google.com/drive/folders/1glouqMz8EUR65V3vfdJNVo6Wn67qTOWy?usp=sharing

## 3. Conclusiones y Recomendaciones

- Con este laboratorio los practicantes demostraron que el stm32 utilizado es un microcontrolador que ofrece altas prestaciones para aplicaciones exigentes. Resulta ser entonces una herramienta que podría ser extremadamente útil para aplicaciones reales de sistemas embebidos. Tiene la capacidad suficiente para aplicaciones "reales" y no solo académicas.
- Su consumo de energía para funcionar es sumamente bajo. Para aplicaciones donde el consumo de energía es importante, este procesador es muy útil. Esto concluyeron los practicantes gracias a la aplicación que se le dio a la batería de alimentación.
- El laboratorio se concluyó con éxito. Cuando se trata de aplicaciones de IoT este microprocesador resulta una excelente opción. Se comprobó su funcionalidad al utilizar la plataforma ThingsBoard y el mcu utilizado demostró su funcionalidad con independencia del factor humano a estímulos externos como sismos.

# Bibliografía

- [1] S. life.argumented. "STM32 32-bit Arm Cortex MCUs". Visitado en Octubre 30. (2019), dirección: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html#overview.
- [2] M. M. V. Fallas, STM32F429 / LibOpenCM3, IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores, ago. de 2022.
- [3] STMicroelectronics, "STM32F427xx STM32F429xx", STMicroelectronics, USA, Datasheet DocID024030 rev10, ene. de 2018.
- [4] STMicroelectronics, "Discovery kit for STM32F429/439 lines", STMicroelectronics, USA, Datasheet DocID024030 rev1, ene. de 2018.

# 4. Apéndices

# life.augmented

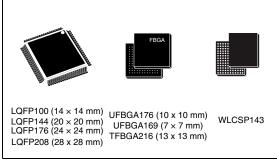
#### STM32F427xx STM32F429xx

32b Arm<sup>®</sup> Cortex<sup>®</sup>-M4 MCU+FPU, 225DMIPS, up to 2MB Flash/256+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 20 com. interfaces, camera & LCD-TFT

Datasheet - production data

#### **Features**

- Core: Arm<sup>®</sup> 32-bit Cortex<sup>®</sup>-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART Accelerator<sup>™</sup>) allowing 0-wait state execution from Flash memory, frequency up to 180 MHz, MPU, 225 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), and DSP instructions
- Memories
  - Up to 2 MB of Flash memory organized into two banks allowing read-while-write
  - Up to 256+4 KB of SRAM including 64-KB of CCM (core coupled memory) data RAM
  - Flexible external memory controller with up to 32-bit data bus: SRAM, PSRAM, SDRAM/LPSDR SDRAM, Compact Flash/NOR/NAND memories
- LCD parallel interface, 8080/6800 modes
- LCD-TFT controller with fully programmable resolution (total width up to 4096 pixels, total height up to 2048 lines and pixel clock up to 83 MHz)
- Chrom-ART Accelerator™ for enhanced graphic content creation (DMA2D)
- · Clock, reset and supply management
  - 1.7 V to 3.6 V application supply and I/Os
  - POR, PDR, PVD and BOR
  - 4-to-26 MHz crystal oscillator
  - Internal 16 MHz factory-trimmed RC (1% accuracy)
  - 32 kHz oscillator for RTC with calibration
  - Internal 32 kHz RC with calibration
- Low power
  - Sleep, Stop and Standby modes
  - V<sub>BAT</sub> supply for RTC, 20×32 bit backup registers + optional 4 KB backup SRAM
- 3×12-bit, 2.4 MSPS ADC: up to 24 channels and 7.2 MSPS in triple interleaved mode
- 2×12-bit D/A converters
- General-purpose DMA: 16-stream DMA controller with FIFOs and burst support
- Up to 17 timers: up to twelve 16-bit and two 32-bit timers up to 180 MHz, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input



- Debug mode
  - SWD & JTAG interfaces
  - Cortex-M4 Trace Macrocell™
- Up to 168 I/O ports with interrupt capability
  - Up to 164 fast I/Os up to 90 MHz
  - Up to 166 5 V-tolerant I/Os
- Up to 21 communication interfaces
  - Up to 3 × I<sup>2</sup>C interfaces (SMBus/PMBus)
  - Up to 4 USARTs/4 UARTs (11.25 Mbit/s, ISO7816 interface, LIN, IrDA, modem control)
  - Up to 6 SPIs (45 Mbits/s), 2 with muxed full-duplex I<sup>2</sup>S for audio class accuracy via internal audio PLL or external clock
  - 1 x SAI (serial audio interface)
  - 2 × CAN (2.0B Active) and SDIO interface
- Advanced connectivity
  - USB 2.0 full-speed device/host/OTG controller with on-chip PHY
  - USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG controller with dedicated DMA, on-chip full-speed PHY and ULPI
  - 10/100 Ethernet MAC with dedicated DMA: supports IEEE 1588v2 hardware, MII/RMII
- 8- to 14-bit parallel camera interface up to 54 Mbytes/s
- True random number generator
- CRC calculation unit
- RTC: subsecond accuracy, hardware calendar
- 96-bit unique ID

These features make the STM32F427xx and STM32F429xx microcontrollers suitable for a wide range of applications:

- Motor drive and application control
- Medical equipment
- Industrial applications: PLC, inverters, circuit breakers
- Printers, and scanners
- Alarm systems, video intercom, and HVAC
- Home audio appliances

Figure 4 shows the general block diagram of the device family.

arm



$\Box$
0
N
4
0
ū
Ö
=
$\mathbf{z}$
æ
<
$\rightarrow$
0
$\overline{}$

Periphe	rals	STM32F427 Vx STM32F429Vx		9Vx	STM32F427 Zx STM32F429Zx		STM32F427 STM32F429 Ax		STM32F427 lx		STM32F429Ix		STM32F429Bx			STM32F42		29Nx								
Flash memory in	Kbytes	1024	2048	512	1024	2048	1024	2048	512	1024	2048	1024	2048	1024	2048	10	024 2048	512	1024	2048	512	1024	2048	512	1024	204
SRAM in	System				•		·						256(112	+16+64	+64)		•							•		
Kbytes	Backup	4																								
FMC memory co	ntroller												Y	es <sup>(1)</sup>												
Ethernet														Yes												
	General- purpose													10												
Timers	Advanced -control													2												
	Basic													2												
Random number	generator													Yes												
	SPI / I <sup>2</sup> S		4/2 (ful	l duple	ex) <sup>(2)</sup>										6/2	2 (fu	ull duplex)(2)									
	I <sup>2</sup> C													3												
	USART/ UART													4/4												
Communication interfaces	USB OTG FS													Yes												
interfaces	USB OTG HS													Yes												
	CAN													2												
	SAI													1												
	SDIO													Yes												
Camera interfac														Yes												
LCD-TFT (STM3 only)	2F429xx	N	0		Yes		No	0		Yes		-	No	Ye	es		No					Yes				
Chrom-ART Acc	elerator™													Yes												
GPIOs				82					114				13	30				140					1	68		
12-bit ADC												•		3							•					
Number of chan	umber of channels			16 24																						



# **115**

#### Table 2. STM32F427xx and STM32F429xx features and peripheral counts (continued)

Table 2. STM32F427XX and STM32F429XX leadures and peripheral counts (continued)												
Peripherals	STM32F427 Vx	STM32F429Vx	STM32F427 Zx	STM32F429Zx	STM32F427 Ax	STM32F429 Ax	STM32F427 lx	STM32F429lx	STM32F429Bx	STM32F429Nx		
12-bit DAC Number of channels		Yes 2										
Maximum CPU frequency		180 MHz										
Operating voltage		1.8 to 3.6 V <sup>(3)</sup>										
Operating temperatures				Ambient to	mperatures:	40 to +85 °C /-	40 to +105 °C					
Operating temperatures	Junction temperature: -40 to + 125 °C											
Packages	LQ	FP100		CSP143 QFP144	UFBC	GA169		BGA176 QFP176	LQFP208	TFBGA216		

For the LOFP100 package, only FMC Bank1 or Bank2 are available. Bank1 can only support a multiplexed NOR/PSRAM memory using the NE1 Chip Select. Bank2 can only support a 16- or 8-bit NAND Flash memory using the NCE2 Chip Select. The interrupt line cannot be used since Port G is not available in this package. For UFBGA169 package, only SDRAM, NAND and multiplexed static memories are supported.

DocID024030 Rev 10

<sup>2.</sup> The SPI2 and SPI3 interfaces give the flexibility to work in an exclusive way in either the SPI mode or the I2S audio mode.

<sup>3.</sup> V<sub>DD</sub>/V<sub>DDA</sub> minimum value of 1.7 V is obtained when the device operates in reduced temperature range, and with the use of an external power supply supervisor (refer to Section 3.17.2: Internal reset OFF).

#### 2.1 Full compatibility throughout the family

The STM32F427xx and STM32F429xx devices are part of the STM32F4 family. They are fully pin-to-pin, software and feature compatible with the STM32F2xx devices, allowing the user to try different memory densities, peripherals, and performances (FPU, higher frequency) for a greater degree of freedom during the development cycle.

The STM32F427xx and STM32F429xx devices maintain a close compatibility with the whole STM32F10xx family. All functional pins are pin-to-pin compatible. The STM32F427xx and STM32F429xx, however, are not drop-in replacements for the STM32F10xx devices: the two families do not have the same power scheme, and so their power pins are different. Nonetheless, transition from the STM32F10xx to the STM32F42x family remains simple as only a few pins are impacted.

Figure 1, Figure 2, and Figure 3, give compatible board designs between the STM32F4xx, STM32F2xx, and STM32F10xx families.

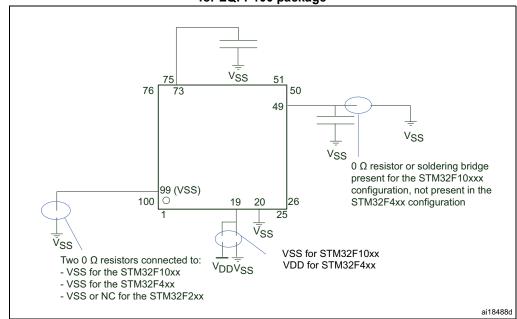


Figure 1. Compatible board design STM32F10xx/STM32F2xx/STM32F4xx for LQFP100 package

57

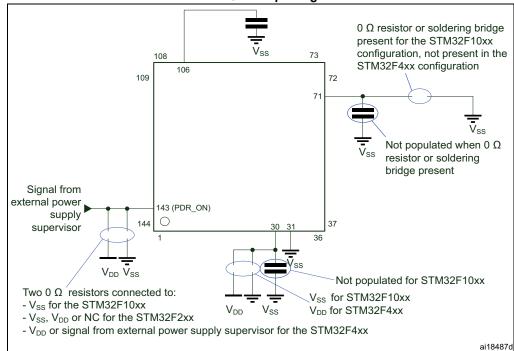
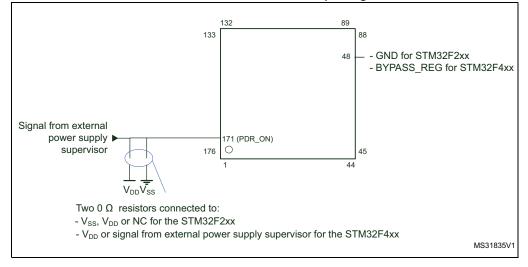


Figure 2. Compatible board design between STM32F10xx/STM32F2xx/STM32F4xx for LQFP144 package

Figure 3. Compatible board design between STM32F2xx and STM32F4xx for LQFP176 and UFBGA176 packages



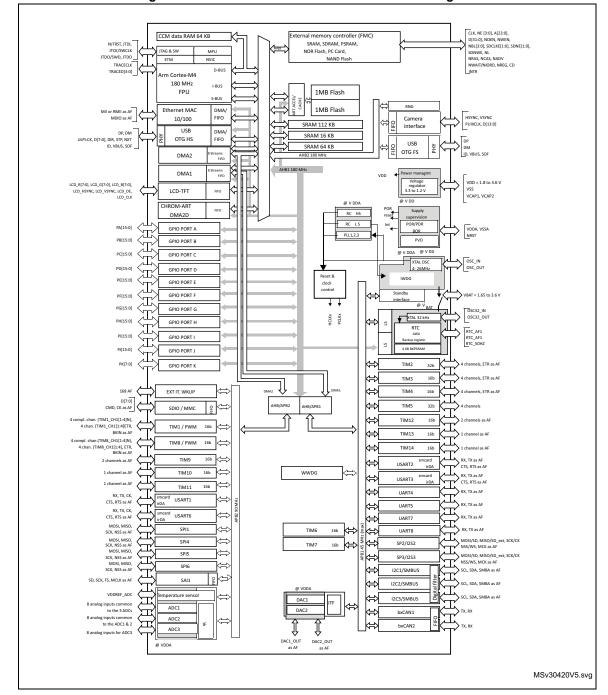


Figure 4. STM32F427xx and STM32F429xx block diagram

2. The LCD-TFT is available only on STM32F429xx devices.

577

The timers connected to APB2 are clocked from TIMxCLK up to 180 MHz, while the timers connected to APB1 are clocked from TIMxCLK either up to 90 MHz or 180 MHz depending on TIMPRE bit configuration in the RCC\_DCKCFGR register.



# UM1670 User manual

## Discovery kit for STM32F429/439 lines

#### Introduction

The STM32F429 Discovery kit (32F429IDISCOVERY) helps you to discover the high performance of the STM32F4 series and to develop your applications. It is based on an STM32F429ZIT6 and includes an ST-LINK/V2 embedded debug tool interface, 2.4" TFT LCD, SDRAM 64 Mbits, Gyroscope ST MEMS, LEDs, pushbuttons and a USB OTG micro-B connector.

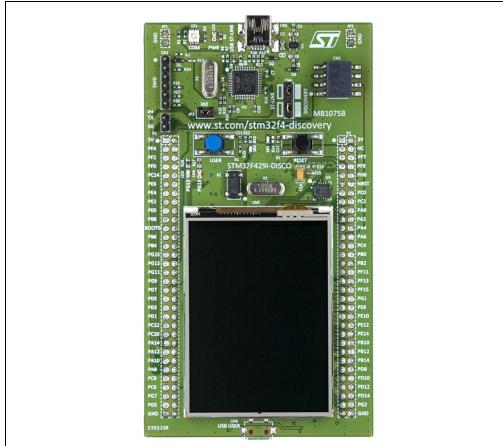


Figure 1. STM32F429 Discovery board

 September 2013
 DocID025175 Rev 1
 1/35

UM1670 Conventions

# 1 Conventions

Table 1 provides the definition of some conventions used in the present document.

Table 1. ON/OFF conventions

Convention	Definition
Jumper JPx ON	Jumper fitted
Jumper JPx OFF	Jumper not fitted
Solder bridge SBx ON	SBx connections closed by solder
Solder bridge SBx OFF	SBx connections left open

Quick start UM1670

#### 2 Quick start

The STM32F429 Discovery is a low-cost and easy-to-use development kit to quickly evaluate and start a development with an STM32F4 series microcontroller.

Before installing and using the product, please accept the Evaluation Product License Agreement from www.st.com/stm32f4-discovery.

For more information on the STM32F429 Discovery board and for demonstration software, visit <a href="https://www.st.com/stm32f4-discovery">www.st.com/stm32f4-discovery</a>.

#### 2.1 Getting started

Follow the sequence below to configure the STM32F429 Discovery board and launch the DISCOVER application:

- 1. Ensure that the jumpers JP3 and CN4 are set to "on" (Discovery mode).
- 2. Connect the STM32F429 Discovery board to a PC using a USB cable type A/mini-B through the USB ST-LINK connector CN1, to power the board. The LEDs LD2 (PWR) and LD1 (COM).
- 3. The following applications are available on the screen:
  - Clock/Calendar and Game
  - Video Player and Image Browser (play videos and view images from the USB mass storage connected to CN6)
  - Performance monitor (watch the CPU load and run a graphical benchmark)
  - System Info
- 4. The demo software, as well as other software examples that allow you to discover the STM32 F4 series features, are available on <a href="https://www.st.com/stm32f4-discovery">www.st.com/stm32f4-discovery</a>.
- 5. Develop your own applications starting from the examples.

#### 2.2 System requirements

- Windows PC (XP, Vista, 7)
- USB type A to mini-B cable

# 2.3 Development toolchain supporting the STM32F429 Discovery kit

Altium: TASKING™ VX-Toolset

Atollic: TrueSTUDIO
 IAR: EWARM
 Keil™: MDK-ARM

#### 2.4 Order code

To order the STM32F429 Discovery kit, use the STM32F429I-DISCO order code.

UM1670 Features

#### 3 Features

The STM32F429 Discovery board offers the following features:

 STM32F429ZIT6 microcontroller featuring 2 MB of Flash memory, 256 KB of RAM in an LQFP144 package

- On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
- Board power supply: through the USB bus or from an external 3 V or 5 V supply voltage
- L3GD20, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output gyroscope
- TFT LCD (Thin-film-transistor liquid-crystal display) 2.4", 262K colors RGB, 240 x 320 dots
- SDRAM 64 Mbits (1 Mbit x 16-bit x 4-bank) including an AUTO REFRESH MODE, and a power-saving
- Six LEDs:
  - LD1 (red/green) for USB communication
  - LD2 (red) for 3.3 V power-on
  - Two user LEDs: LD3 (green), LD4 (red)
  - Two USB OTG LEDs:
     LD5 (green) VBUS and LD6 (red) OC (over-current)
- Two pushbuttons (user and reset)
- USB OTG with micro-AB connector
- Extension header for LQFP144 I/Os for a quick connection to the prototyping board and an easy probing

Hardware layout UM1670

## 4 Hardware layout

The STM32F429 Discovery board has been designed around the STM32F429ZIT6 microcontroller in a 144-pin LQFP package.

*Figure 1* illustrates the connections between the STM32F429ZIT6 and its peripherals (ST-LINK/V2, pushbutton, LED, USB OTG, Gyroscope ST MEMS, Accelerometer + Magnetometer ST MEMS, and connectors).

Figure 2 and Figure 3 help you to locate these features on the STM32F429 Discovery board.

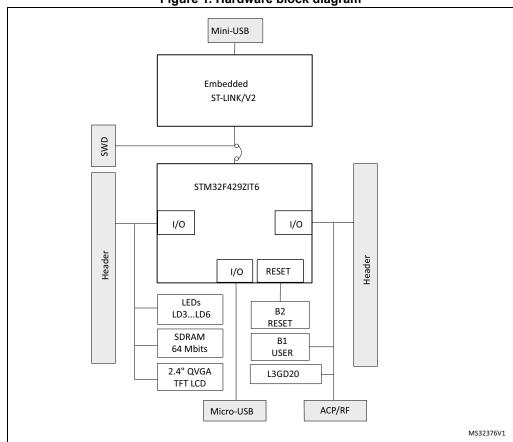
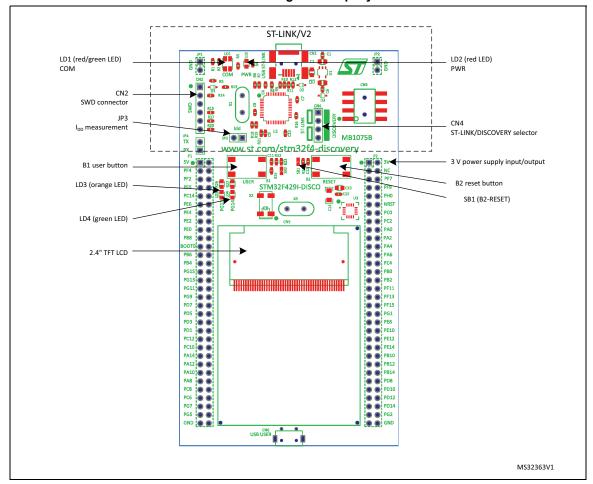


Figure 1. Hardware block diagram

UM1670 Hardware layout

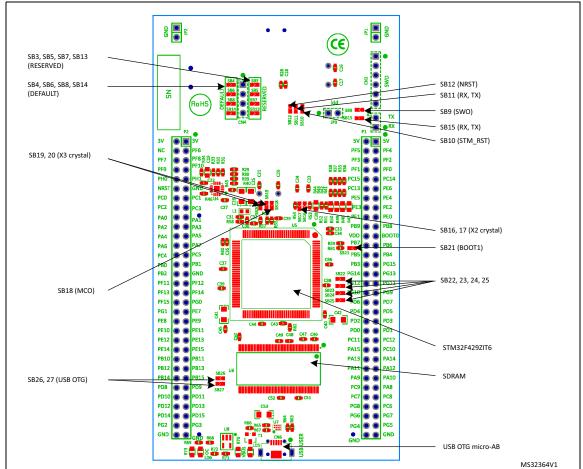
Figure 2. Top layout



57

Hardware layout UM1670

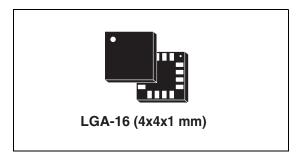
Figure 3. Bottom layout





# MEMS motion sensor: three-axis digital output gyroscope

Datasheet - production data



#### **Features**

- Three selectable full scales (250/500/2000 dps)
- I<sup>2</sup>C/SPI digital output interface
- 16 bit-rate value data output
- 8-bit temperature data output
- Two digital output lines (interrupt and data ready)
- Integrated low- and high-pass filters with userselectable bandwidth
- Wide supply voltage: 2.4 V to 3.6 V
- Low voltage-compatible IOs (1.8 V)
- Embedded power-down and sleep mode
- Embedded temperature sensor
- Embedded FIFO
- High shock survivability
- Extended operating temperature range (-40 °C to +85 °C)
- ECOPACK<sup>®</sup> RoHS and "Green" compliant

#### **Applications**

- · Gaming and virtual reality input devices
- Motion control with MMI (man-machine interface)
- GPS navigation systems
- Appliances and robotics

#### **Description**

The L3GD20 is a low-power three-axis angular rate sensor.

It includes a sensing element and an IC interface capable of providing the measured angular rate to the external world through a digital interface (I<sup>2</sup>C/SPI).

The sensing element is manufactured using a dedicated micro-machining process developed by STMicroelectronics to produce inertial sensors and actuators on silicon wafers.

The IC interface is manufactured using a CMOS process that allows a high level of integration to design a dedicated circuit which is trimmed to better match the sensing element characteristics. The L3GD20 has a full scale of ±250/±500/ ±2000 dps and is capable of measuring rates with a user-selectable bandwidth.

The L3GD20 is available in a plastic land grid array (LGA) package and can operate within a temperature range of -40 °C to +85 °C.

**Table 1. Device summary** 

Order code	Temperature range (°C)	Package	Packing
L3GD20	-40 to +85	LGA-16 (4x4x1 mm)	Tray
L3GD20TR	-40 to +85	LGA-16 (4x4x1 mm)	Tape and reel

List of figures L3GD20

# List of figures

Figure 1.	Block diagram	. 5
Figure 2.	Pin connection	
Figure 3.	SPI slave timing diagram	. 9
Figure 4.	I2C slave timing diagram	10
Figure 5.	L3GD20 electrical connections and external component values	13
Figure 6.	Block diagram	14
Figure 7.	Bypass mode	15
Figure 8.	FIFO mode	16
Figure 9.	Stream mode	17
Figure 10.	Bypass-to-stream mode	18
Figure 11.	Trigger stream mode	18
Figure 12.	Read and write protocol	23
Figure 13.	SPI read protocol	24
Figure 14.	Multiple byte SPI read protocol (2-byte example)	24
Figure 15.	SPI write protocol	25
Figure 16.	Multiple byte SPI write protocol (2-byte example)	25
Figure 17.	SPI read protocol in 3-wire mode	26
Figure 18.	INT1_Sel and Out_Sel configuration block diagram	33
Figure 19.	Wait disabled	39
Figure 20.	Wait enabled	39
Figure 21.	LGA-16: mechanical data and package dimensions	40

6/44 DocID022116 Rev 2

#### Block diagram and pin description 1

LOW-PASS FILTER CHARGE Y+ AMP A D C 1 -□ CS -□ SCL/SPC -□ SDA/SDO/SDI II SDO A D C 2 E N S O R DRIVING MASS Feedback loop CONTROL LOGIC TRIMMING REFERENCE FIFO & PHASE GENERATOR CIRCUITS INTERRUPT GEN. DRDY/INT2 AM10126V1

Figure 1. Block diagram

Note:

The vibration of the structure is maintained by drive circuitry in a feedback loop. The sensing signal is filtered and appears as a digital signal at the output.

#### Pin description 1.1

 $\overrightarrow{+\Omega}_{\mathbf{Z}}$ RES 12 Vdd\_IO **BOTTOM RES** SCL/SPC **VIEW RES** SDA/SDI/SDO RES 9 SDO/SA0 INT1 **DRDY/INT2** (TOP VIEW) **DIRECTIONS OF THE** DETECTABLE ANGULAR RATES AM10127V1

Figure 2. Pin connection

Table 3.

Table 2. Pin description

Pin#	Name	Function				
1	Vdd_IO <sup>(1)</sup>	Power supply for I/O pins				
2	SCL	I <sup>2</sup> C serial clock (SCL)				
	SPC	SPI serial port clock (SPC)				
	SDA	I <sup>2</sup> C serial data (SDA)				
3	SDI	SPI serial data input (SDI)				
	SDO	3-wire interface serial data output (SDO)				
4	SDO	SPI serial data output (SDO)				
4	SA0	I <sup>2</sup> C less significant bit of the device address (SA0)				
5	CS	I <sup>2</sup> C/SPI mode selection (1: SPI idle mode / I <sup>2</sup> C communication enabled; 0: SPI communication mode / I <sup>2</sup> C disabled)				
6	DRDY/INT2	Data ready/FIFO interrupt (Watermark/Overrun/Empty)				
7	INT1	Programmable interrupt				
8	Reserved	Connect to GND				
9	Reserved	Connect to GND				
10	Reserved	Connect to GND				
11	Reserved	Connect to GND				
12	Reserved	Connect to GND				
13	GND	0 V supply				
14	Reserved	Connect to GND with ceramic capacitor <sup>(2)</sup>				
15	Reserved	Connect to Vdd				
16	Vdd <sup>(3)</sup>	Power supply				

<sup>1. 100</sup> nF filter capacitor recommended.

<sup>2. 1</sup> nF min value must be guaranteed under 11 V bias condition.

<sup>3. 100</sup> nF plus 10  $\mu$ F capacitors recommended.

# 2 Mechanical and electrical specifications

#### 2.1 Mechanical characteristics

@ Vdd = 3.0 V, T = 25 °C unless otherwise noted.

Table 4. Mechanical characteristics<sup>(1)</sup>

Symbol	Parameter	Test condition	Min.	Typ. <sup>(2)</sup>	Max.	Unit	
				±250			
FS	Measurement range	User-selectable		±500		dps	
				±2000			
		FS = 250 dps		8.75			
So	Sensitivity	FS = 500 dps		17.50		mdps/digit	
		FS = 2000 dps		70			
SoDr	Sensitivity change vs. temperature	From -40 °C to +85 °C		±2		%	
	Digital zero-rate level	FS = 250 dps		±10			
DVoff		FS = 500 dps		±15		dps	
		FS = 2000 dps		±75		ı	
OffDr	Zero-rate level change	FS = 250 dps		±0.03		dps/°C	
Olibi	vs. temperature	FS = 2000 dps		±0.04		dps/°C	
NL	Non linearity	Best fit straight line		0.2		% FS	
Rn	Rate noise density			0.03		lps/(√Hz)	
ODR	Digital output data rate			95/190/ 380/760		Hz	
Тор	Operating temperature range		-40		+85	°C	

<sup>1.</sup> The product is factory calibrated at 3.0 V. The operational power supply range is specified in *Table 5*.

<sup>2.</sup> Typical specifications are not guaranteed.

#### 2.2 Electrical characteristics

@ Vdd =3.0 V, T=25 °C unless otherwise noted.

Table 5. Electrical characteristics (1)

Symbol	Parameter	Test condition	Min.	Typ. <sup>(2)</sup>	Max.	Unit
Vdd	Supply voltage		2.4	3.0	3.6	V
Vdd_IO	I/O pins supply voltage <sup>(3)</sup>		1.71		Vdd+0.1	V
ldd	Supply current			6.1		mA
IddSL	Supply current in sleep mode <sup>(4)</sup>	Selectable by digital interface		2		mA
IddPdn	Supply current in power-down mode	Selectable by digital interface		5		μА
VIH	Digital high level input voltage		0.8*Vdd_I O			V
VIL	Digital low level input voltage				0.2*Vdd_I O	V
Тор	Operating temperature range		-40		+85	°C

<sup>1.</sup> The product is factory calibrated at 3.0 V.

## 2.3 Temperature sensor characteristics

@ Vdd =3.0 V, T=25 °C unless otherwise noted.

Table 6. Electrical characteristics (1)

Symbol	Parameter	Test condition	Min.	Typ. <sup>(2)</sup>	Max.	Unit
TSDr	Temperature sensor output change vs. temperature			-1		°C/digit
TODR	Temperature refresh rate	-		1		Hz
Тор	Operating temperature range		-40		+85	°C

<sup>1.</sup> The product is factory calibrated at 3.0 V.

<sup>2.</sup> Typical specifications are not guaranteed.

<sup>3.</sup> It is possible to remove Vdd maintaining Vdd\_IO without blocking the communication busses; in this condition the measurement chain is powered off.

<sup>4.</sup> Sleep mode introduces a faster turn-on time relative to power-down mode.

<sup>2.</sup> Typical specifications are not guaranteed.



# **Specification**

Version: V1.11

Document No.: ILI9341\_DS\_V1.11.pdf

#### ILI TECHNOLOGY CORP.

8F, No. 38, Taiyuan St., Jhubei City, Hsinchu Country 302 Taiwan R.O.C. Tel.886-3-5600099; Fax.886-3-5670585 http://www.ilitek.com





14.2.	Gamma Curves	224
14	4.2.1. Gamma Curve 1 (GC0), applies the function y=x <sup>2.2</sup>	224
14.3.	Gamma Curves	225
14	1.3.1. Grayscale Voltage Generation	225
14	1.3.2. Positive Gamma Correction	226
14	1.3.3. Negative Gamma Correction	227
15. Reset		228
15.1. l	Registers	228
15.2.	Output Pins, I/O Pins	229
15.3. l	nput Pins	229
15.4. l	Reset Timing	230
16. Configur	ation of Power Supply Circuit	231
17. NV Mem	ory Programming Flow	234
18. Electrica	Characteristics	235
18.1	Absolute Maximum Ratings	235
18.2 l	DC Characteristics	236
18	3.2.1 General DC Characteristics	236
18.3	AC Characteristics	238
18	3.3.1 Display Parallel 18/16/9/8-bit Interface Timing Characteristics (8080- I system)	238
18	3.3.2 Display Parallel 18/16/9/8-bit Interface Timing Characteristics (8080- $\scriptstyle\rm II$ system)	240
18	3.3.3 Display Serial Interface Timing Characteristics (3-line SPI system)	242
18	3.3.4 Display Serial Interface Timing Characteristics (4-line SPI system)	243
18	3.3.5 Parallel 18/16/6-bit RGB Interface Timing Characteristics	244
19 Revision	History	245





#### 1. Introduction

ILI9341 is a 262,144-color single-chip SOC driver for a-TFT liquid crystal display with resolution of 240RGBx320 dots, comprising a 720-channel source driver, a 320-channel gate driver, 172,800 bytes GRAM for graphic display data of 240RGBx320 dots, and power supply circuit.

ILI9341 supports parallel 8-/9-/16-/18-bit data bus MCU interface, 6-/16-/18-bit data bus RGB interface and 3-/4-line serial peripheral interface (SPI). The moving picture area can be specified in internal GRAM by window address function. The specified window area can be updated selectively, so that moving picture can be displayed simultaneously independent of still picture area.

ILI9341 can operate with 1.65V ~ 3.3V I/O interface voltage and an incorporated voltage follower circuit to generate voltage levels for driving an LCD. ILI9341 supports full color, 8-color display mode and sleep mode for precise power control by software and these features make the ILI9341 an ideal LCD driver for medium or small size portable products such as digital cellular phones, smart phone, MP3 and PMP where long battery life is a major concern.

#### 2. Features

- Display resolution: [240xRGB](H) x 320(V)
- Output:
  - > 720 source outputs
  - 320 gate outputs
  - Common electrode output (VCOM)
- a-TFT LCD driver with on-chip full display RAM: 172,800 bytes
- System Interface
  - ➤ 8-bits, 9-bits, 16-bits, 18-bits interface with 8080- I /8080- II series MCU
  - 6-bits, 16-bits, 18-bits RGB interface with graphic controller
  - > 3-line / 4-line serial interface
- Display mode:
  - > Full color mode (Idle mode OFF): 262K-color (selectable color depth mode by software)
  - > Reduce color mode (Idle mode ON): 8-color
- Power saving mode:
  - Sleep mode
- On chip functions:
  - VCOM generator and adjustment
  - Timing generator
  - Oscillator
  - DC/DC converter
  - Line/frame inversion
  - 1 preset Gamma curve with separate RGB Gamma correction
- Content Adaptive Brightness Control
- MTP (3 times):
  - > 8-bits for ID1, ID2, ID3
  - 7-bits for VCOM adjustment



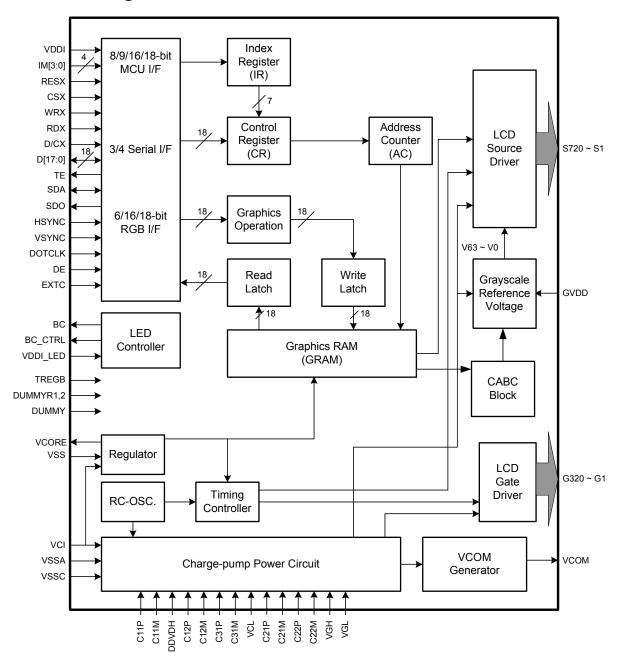


- Low -power consumption architecture
  - Low operating power supplies:
    - VDDI = 1.65V ~ 3.3V (logic)
    - VCI = 2.5V ~ 3.3V (analog)
- LCD Voltage drive:
  - Source/VCOM power supply voltage
    - DDVDH GND = 4.5V ~ 5.8V
    - VCL GND = -1.5V ~ -2.5V
  - Gate driver output voltage
    - VGH GND = 10.0V ~ 18.0V
    - VGL GND = -5.0V ~ -10.0V
    - VGH VGL  $\leq$  28V
  - VCOM driver output voltage
    - VCOMH = 3.0V ~ (DDVDH 0.2)V
    - VCOML = (VCL+0.2)V ~ 0V
    - VCOMH VCOML  $\leq 6.0$ V
- $\bullet$  Operate temperature range: -40°C to 85°C
- ◆ a-Si TFT LCD storage capacitor : Cst on Common structure only





## 3. Block Diagram







# 4. Pin Descriptions

Power Supply Pins						
Pin Name	I/O	Type	Descriptions			
VDDI	I	Р	Low voltage power supply for interface logic circuits (1.65 ~ 3.3 V)			
VDDI_LED	I		Power supply for LED driver interface. (1.65 ~ 3.3 V)  If LED driver is not used, fix this pin at VDDI.			
VCI		Analog Power	High voltage power supply for analog circuit blocks (2.5 ~ 3.3 V)			
Vcore	0	Digital Power	Regulated Low voltage level for interface circuits  Connect a capacitor for stabilization.  Don't apply any external power to this pad			
VSS3	I	I/O Ground	System ground level for I/O circuits.			
VSS	I	Digital Ground	System ground level for logic blocks			
VSSA	I	Analog Ground	System ground level for analog circuit blocks Connect to VSS on the FPC to prevent noise.			
VSSC	I	Analog Ground	System ground level for analog circuit blocks Connect to VSS on the FPC to prevent noise			

Interface Logic Signals														
Pin Name	I/O	Type	Descriptions											
			- Select the MCU interface mode											
			13.40	IM2	18.44	11.40	MOULL	DB Pin in use						
			IM3	IIVI2	IM1	IM0	MCU-Interface Mode	Register/Content	GRAM					
			0	0	0	0	80 MCU 8-bit bus interface I	D[7:0]	D[7:0]					
			0	0	0	1	80 MCU 16-bit bus interface I	D[7:0]	D[15:0]					
			0	0	1	0	80 MCU 9-bit bus interface I	D[7:0]	D[8:0]					
			0	0	1	1	80 MCU 18-bit bus interface I	D[7:0]	D[17:0]					
	I (V		0	1	0	1	3-wire 9-bit data serial interface I	SDA: In/O	UT					
			0	1	1	0	4-wire 8-bit data serial interface I SDA: In/OU		UT					
IM[3:0]			(VDDI/VSS)	1	0	0	0	80 MCU 16-bit bus interface Ⅱ	D[8:1]	D[17:10], D[8:1]				
			1	0	0	1	80 MCU 8-bit bus interface Ⅱ	D[17:10]	D[17:10]					
			1	0	1	0	80 MCU 18-bit bus interface Ⅱ	D[8:1]	D[17:0]					
				1	0	1	1	80 MCU 9-bit bus interface II	D[17:10]	D[17:9]				
			1	1	0	1	3-wire 9-bit data serial interface II	SDI: In SDO: Out						
									1	1	1	0	4-wire 8-bit data serial interface Ⅱ	SDI: In SDO: Ou
			MPU Parallel interface bus and serial interface select											
			If use RGB Interface must select serial interface.											
			* : Fix	this p	oin at	VDDI	or VSS.							